规格型号	XSW20-5gm	XSW60-5gc	XDW60-9uc	XDW170-12uc	XDW80-12uc-T
图像尺寸	2448 x 2048 像素（黑白）	2448 x 2048 像素（彩色）	4112 x 2176 像素（彩色）	4096 x 3000 像素（彩色）	4096 x 3000 像素（彩色）
DLP投影个数	1	1	2	2	2
测量速度	0.5 s / FOV	0.5 s / FOV	0.8 s / FOV	1.5 s / FOV	1.5 s / FOV
Z向基准距离（距外壳中部）	180 mm	180 mm	137 mm	180 mm	263 mm（距离镜头底部）
XY视野（Z基准距离）	24 x 20 mm	65 x 54 mm	62 x 33 mm	172 x 126 mm	85 x 62 mm
XY方向分辨率（Z基准距离）	10 μm	25 μm	15μm	42 μm	20 μm
Z向测量范围（距基准距离）	±5 mm	±10 mm	±10 mm	±25 mm	±15 mm
Z向测量精度	8 μm	20 μm	10 μm	25 μm	10 μm
重复测量精度（σ）	1 μm	3 μm	2 μm	5 μm	2 μm
测量用光源	RGB 三色（LED）	RGB 三色（LED）	RGB 三色（LED）	RGB 三色（LED）	RGB 三色（LED）
图像传输接口	千兆网	千兆网	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
IO接口	外部触发	外部触发	外部触发	外部触发	外部触发
工作电压	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	AC 220V
额度功率	60 W	60 W	100 W	100 W	110 W
工作温度	0~40 °C	0~40 °C	0~40 °C	0~40 °C	0~40 °C
存储温度	-30~70 °C	-30~70 °C	-30~70 °C	-30~70 °C	-30~70 °C
外形尺寸	W260 x D195 x H78 mm	W260 x D195 x H78 mm	W360 x D225 x H78 mm	W380 x D210 x H70mm	W760 x D200 x H550mm
重量	2.5kg	2.5kg	3kg	3.5kg	15kg
集成测量平台					
二维测量工具	点、线、圆、椭圆拟台;宽度、长度、直径、距离、位置度、角度、平行度计算				
三维测量工具	平面度、段差、粗糙度、形状拟合、体积估算				
定位测量工具	主要以形状、灰度、模板进行匹配的算法对位工具，准确计算来料偏差并给出修正结果				
通信接口	支持标准工业协议方便与用户应用、第三方图像处理软件、机器人和PLC集成				
推荐配置	CPU：Intel® Core™i5 6600处理器同级规格或以上 内存：4G以上　硬盘:500G以上　系统:WIN7 64位以上				